

●クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2 管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)(歯科用シーリング・コーティング材)
医療機器認証番号:305ABBZX00012000

- 印刷のため、現品と色調が異なることがあります。 ●ご使用に際しましては電子添文等を必ずお読み下さい。
- 仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。

クラレノリタケデンタル株式会社

お問い合わせ

☎ 0120-330-922 平日 10:00~17:00

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー

【製造販売元】クラレノリタケデンタル株式会社
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

【販売元】株式会社モリタ
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町33-3-18
お客様相談センター: 0800-222-8020 (医療従事者様向窓口)

クラレノリタケデンタル
LINE公式アカウント

友だち追加はこちらから



最新情報
配信中!

【クリアフィル】、【MDP】、【パナビア】及び【SA ルーティング】は株式会社クラレの登録商標です。
T753-03 03/2025

kuraray

Noritake

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント

医療機器認証番号: 230ABBZX00096000

SA ルーティング® Multi

かんたんガイド

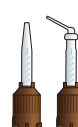


ご使用に際して必要なもの

オートミックス



「SA ルーティング® Multi」
オートミックス

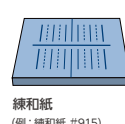


ミキシングチップ(合適用)
または、
ミキシングチップ(エンド用)
+ ガイドチップ(エンド用極細)

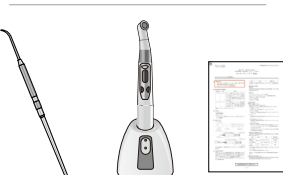
ハンドミックス



「SA ルーティング® Multi」
ハンドミックス



オートミックス、ハンドミックス共通



エクスプローラー
(余剰セメントの除去用) 歯科重合用
光照射器 製品の添付文書、
取扱説明書

●より高い接着力を求める場合に
支台歯処理に用います。

クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2



はじめてお使いの方へ 2~3 ページ

使用ステップの概要 4~9 ページ

①金属クラウンの接着 4 ページ

②CAD/CAMレジン冠の接着 6 ページ

③間接法レジンコアの接着 8 ページ

Q&A 10~15 ページ

ご使用の前には必ず製品の添付文書及び取扱説明書に
記載の使用方法・注意事項をお読みください。

「S Aルーティング® Multi」は、さまざまな補綴装置と
支台歯へプライマー処理なしで接着できるレジンセメントです。

補綴装置

*各材料により作成されたクラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着に用います。



メタル
(貴金属合金・非貴金属合金)



ジルコニア



CAD/CAM
レジン冠



歯科用陶材



シリカ系
ガラスセラミックス
(ニケイ酸リチウムなど)

支台歯



メタルコア
(貴金属合金・非貴金属合金)



天然歯
(エナメル質・象牙質)



レジンコア

余剰セメントの除去がカンタン

余剰セメント除去のタイミングを光照射/化学硬化より選択可能。
半硬化した余剰セメントは容易に除去できます。

光照射による方法



2～5秒 光照射

「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」
を併用する場合は、1～2秒光照射

化学硬化による方法



2～4分 保持

半硬化した余剰セメントが
スルッと除去できる



X線造影性 ※1	あり
被膜厚さ ※1	約 16μm
室温保存可能	保管温度 2～25℃

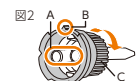
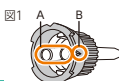
※1 試験方法：JIS T6611 条件などにより数値は異なります。
診療時間後や在庫の保管に際しましては、直射日光・デンタル
ライトなどを避けてください。また、夏季など室温が上記の保
管温度を超える場合には冷蔵庫での保管をお願いいたします。

オートミックス

● ミキシングチップの準備

1

図1の位置でシリンジに装着ください。図2の場合にはCを回転させて、AとBの位置関係を図1になるようにしてください。



2

キャップを反時計回りに1/4回転させて、突起部とシリンジの溝を合わせ、根元を持って下方向に折るように取り外してください。



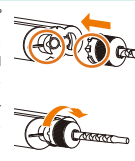
3

少量ペーストを押し出し、均等に出ることを確認してください。
※均等に出ない場合、硬化不良を起こす場合があります。



4

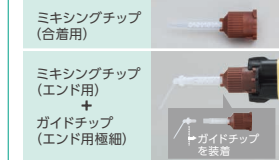
ミキシングチップをシリンジの溝に合わせて奥まで押し込んで、ミキシングチップを時計回りに1/4回転させてください。



●「選べる2種類のチップ」と「スムーズな押し出し」により、症例に適したスピーディーな操作が行えます。

選べる2種類のチップ

クラウンなどの装着 / 根管内への注入に対応した2種類のチップ



スムーズな押し出し

自動練和によるスピーディーな操作性



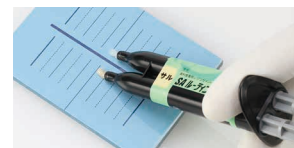
●操作時間は遮光下(23℃)でミキシングチップを通して練和開始から1分以内です。
●直接口腔内で使用する場合には、交差感染を防ぐため、市販の保護カバーなどでシリンジ全体を覆ってください。

① POINT

●使用後はミキシングチップを取り外し、 ●練和開始後はミキシングチップ及びガイドチップの透明な部分にデンタルライトなどの強い光が当たらないキャップを装着して保管してください。 ように注意してください。チップ内のペーストが硬化する場合や操作時間が短くなる恐れがあります。

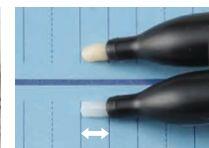
ハンドミックス

●採取量が調整できるダブルシリンジを採用。練和紙へのペースト採取がカンタンです。

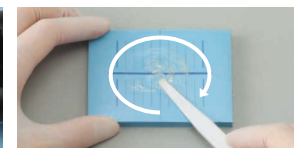


使用回数 クラウン 約 60回
インレー 約 120回

#915練和紙には5mm刻みの目盛りがついています。



練和紙 1目盛り が
クラウン 1歯分 相当



練和紙上に薄く広げるように
10秒間練和を行います。

●操作時間は遮光下(23℃)で練和開始から2分以内です。

●デンタルライトなどの強い光が当たると硬化が早くなりますので、ペースト採取後は速やかに接着操作を行ってください。

●ペーストの練和中に水滴が付着するとペーストの硬化が早くなる場合がありますので、練和紙、練和棒に水滴が付着している場合は拭き取ってからご使用ください。

光に注意



① POINT

●Aペースト、Bペーストが等量採取できていることを確認してからご使用ください。
●ペーストの採取後はすぐにキャップを締めてください。また、シリンジの先端が汚れた場合は乾いたガーゼ等で拭き取ってから、キャップを締めてください。

① POINT

*金属製のスパチュラを使用するとセメントペーストに金属色に移ってしまう為、プラスチック製の練和棒(品番#906)をご使用ください。

接着前の準備



通法に従い、仮封材、仮着材の除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿を行ってください。

※清掃時に過酸化水素を使用すると接着力が低下しますので、使用しないでください。

補綴装置の準備



補綴装置の前処理

補綴装置の添付文書にしたがい、前処理。指定がない場合は、下記の方法を推奨します。

- 30～50μmアルミナ粒子にて0.1～0.4MPa (1～4kgf/cm²)の空気圧でサンドブラスト処理。
- 超音波洗浄2分間、エアブローにて乾燥。
(サンドブラスト処理後に試適した場合、リン酸エッチング材等を添付文書にしたがい処理、水洗・乾燥。) ※リン酸エッチング材は5秒間処理。

「SAルーティング® Multi」の特長

ペースト内に配合した「MDP®」と長鎖シランカップリング剤「LCSi」により、様々な種類の補綴装置に対して、プライマー処理なしで高接着。



リン酸エステル系モノマー
「MDP®」

歯質・金属・ジルコニアなどに高い接着性を有する。



長鎖シランカップリング剤
「LCSi」

CAD/CAMレジン冠、シリカ系ガラスセラミックス（ニケイ酸リチウム）、歯科用陶材へ高い接着性を有する。

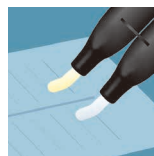
STEP 1 ペーストの準備

オートミックスの場合

3ページの「ミキシングチップの準備」にしたがい、ミキシングチップを取り付けます。

ハンドミックスの場合

AペーストとBペーストの等量採取



STEP 2 ペーストの練和



ハンドミックスの場合

10秒練和

デンタルライトなどの強い光が当たると硬化が早くなりますので、ペースト採取後は速やかに接着操作を行ってください。



STEP 3 ペーストの塗布

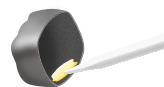
支台歯（窩洞）側へペーストを塗布した場合は40秒以内に装着操作を行ってください。

オートミックスの場合



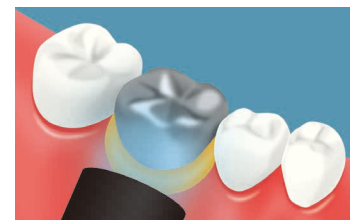
クラウンの被着面全体または窩洞内に塗布。
○直接口腔内で使用する場合
交差感染を防ぐため、市販の保護カバーなどでシリンジ全体を覆ってください。

ハンドミックスの場合



クラウンの被着面全体または窩洞内に塗布。

STEP 4 余剰セメントの半硬化



光重合による方法

一ヶ所につき 2～5秒 光照射

化学重合による方法

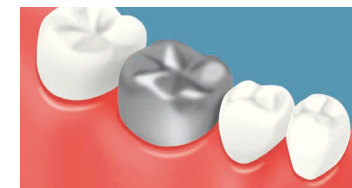
補綴装置の装着から 2～4分 保持

STEP 5 余剰セメントの除去



半硬化した余剰セメントを探針などで除去。浮き上がりを防止するため、補綴装置を押さえながら余剰セメントを除去します。

STEP 6 最終硬化



光を透過しない補綴装置の場合

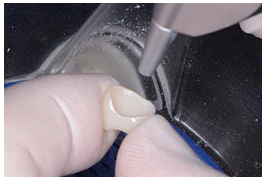
補綴装置の装着後、5分保持し化学硬化させます。

接着前の準備

通法に従い、仮封材、仮着材の除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿を行ってください。

*清掃時に過酸化水素を使用すると接着力が低下しますので、使用しないでください。

補綴装置の準備



補綴装置の前処理 ※2

補綴装置の添付文書にしたがい、前処理。指定がない場合は、下記の方法を推奨します。

- 30～50μmアルミナ粒子にて0.1～0.2MPa (1～2kgf/cm²) の空気圧でサンドブラスト処理。
- 超音波洗浄2分間、エアブローにて乾燥。
(サンドブラスト処理後に試適した場合、リン酸エッチング材等を添付文書にしたがい処理、水洗・乾燥。)*リン酸エッチング材は5秒間処理。

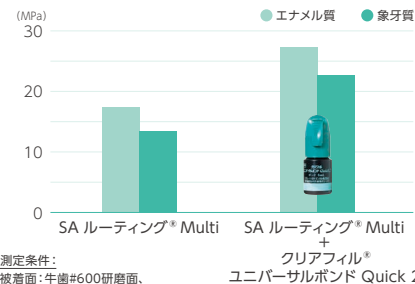
※2 歯科セラミックス用接着材料を適用することで、内面処理加算が可能です。

STEP 1 「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」の採取

「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」の採取。

人歯せん断接着強度

「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」との併用により歯質への接着力が向上します。



POINT

CAD/CAMレジン冠の接着など、より高い接着を求める場合には、「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」による支台歯処理を行います。



※1 添付文書記載の使用用途 1) クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着 (被着面が無機物フィラーを含むレジン系材料) を示します。補綴装置を試適し、窩洞、支台歯との適合性を確認してから、接着操作を行ってください。

STEP 2 「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」の塗布



ボンド塗布

5秒以上乾燥 (弱～中圧) ※3

※3 パキュームで吸引しながら、液面が動かなくなるまで乾燥

ボンド塗布後の待ち時間・光照射は不要です。

STEP 3 ペーストの準備

オートミックスの場合

3ページの「ミキシングチップの準備」にしたがい、ミキシングチップを取り付けます。

ハンドミックスの場合

AペーストとBペーストの等量採取



STEP 6 余剰セメントの半硬化



光重合による方法 ※4

一ヶ所につき 1～2秒光照射

※4 「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」を併用する場合、ボンドの影響で光硬化が速くなります。

化学重合による方法

補綴装置の装着から 2～4分保持

STEP 4 ペーストの練和



ハンドミックスの場合

10秒練和

デンタルライトなどの強い光が当たると硬化が早くなりますので、ペースト採取後は速やかに接着操作を行ってください。



STEP 5 ペーストの塗布

支台歯 (窩洞) 側へペーストを塗布した場合は30秒以内に装着操作を行ってください。「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」を併用した場合は、ボンドの影響で硬化が速くなります。

オートミックスの場合

クラウンの被着面全体または窩洞内に塗布。
○直接口腔内で使用する場合は、交差感染を防ぐため、市販の保護カバーなどでシリンジ全体を覆ってください。

ハンドミックスの場合

クラウンの被着面全体または窩洞内に塗布。



STEP 7 余剰セメントの除去



半硬化した余剰セメントを探针などで除去。浮き上がりを防止するため、補綴装置を押さえながら余剰セメントの除去を行います。

STEP 8 最終硬化



補綴装置全体及びマージン部に光照射を行います。

分類	光源	光量	照射時間
高出力LED照射器	青色LED	1500mW/cm ² 以上	(3秒又は5秒) ×2回
LED照射器		800～1400mW/cm ²	10秒
ハロゲン照射器	ハロゲンランプ	400mW/cm ² 以上	10秒

・LED照射器: 光源が青色LEDで発光スペクトルのピークトップが450～480nm
・ハロゲン照射器: 有効波長域が400～515nm

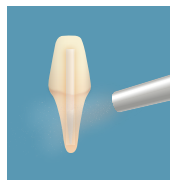
築造窩洞及び根管の準備

通法に従い、仮封材、仮着材の除去、被着面（築造窩洞及び根管）の清掃、防湿を行ってください。

○築造窩洞の形成、コア又はポストの試通
通法にしたがい根管形成、根管充填を行った後、築造窩洞を形成。形成した築造窩洞にコア又は適切な太さのポストを試通します。ポストの場合は必要に応じて切断してください。エタノールを染み込ませたガーゼやワッテ等で汚れを拭き取ります。

*清掃時に過酸化水素を使用すると接着力が低下しますので、使用しないでください。

補綴装置の準備



補綴装置の前処理

補綴装置の添付文書にしたがい、前処理。指定がない場合は、下記の方法を推奨します。

●30～50μmアルミナ粒子にて0.1～0.2MPa（1～2kg f/cm²）の空気圧でサンドブラスト処理。グラスファイバーポストは損傷を避けるため、サンドブラスト処理は行いません。

●超音波洗浄2分間、エアブローにて乾燥。
（サンドブラスト処理後に試通した場合、添付文書に従い、リン酸エッチング材等で処理、水洗・乾燥。） *リン酸エッチング材は5秒間処理。

STEP 1 パーストの準備

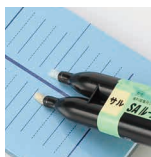
オートミックスの場合

3ページの「ミキシングチップの準備」を参照し、チップを取り付けます

根管内へのペースト塗布には、ミキシングチップ（エンド用）に、ガイドチップ（エンド用極細）を装着します。

ハンドミックスの場合

AペーストとBペーストの等量採取



STEP 2 パーストの練和



ハンドミックスの場合

10秒練和

デンタルライトなどの強い光が当たると硬化が早くなりますので、ペースト採取後は速やかに接着操作を行ってください。

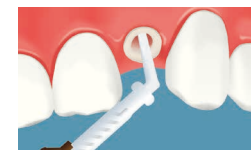


STEP 3 コアの装着

漏斗状根管への接着など、より高い接着を求める場合には、「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」による歯面処理が有効です。

オートミックスの場合

根管内にペーストを填入し、その後気泡が入らないようにコアを装着。



POINT
○直接口腔内で使用する場合
交差感染を防ぐため、市販の保護カバーなどでシリンジ全体を覆ってください

ハンドミックスの場合

CRシリンジ等を用いて根管内にペーストを填入し、その後気泡が入らないようにコアを装着。

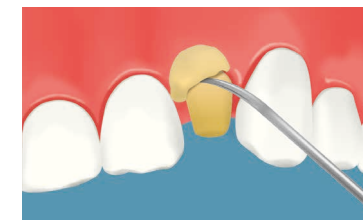


POINT
レンツロを使用すると硬化が早くなるので、使用しないでください。

気泡の混入に注意

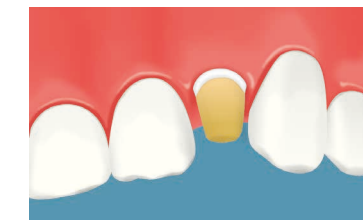
根管内へペーストを塗布した場合は40秒以内に装着を行ってください。
「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」を併用した場合は、30秒以内に装着をおこなってください。

STEP 5 余剰セメントの除去



半硬化した余剰セメントを探針などで除去。浮き上がりを防止するため、補綴装置を押さえながら余剰セメントの除去を行います。

STEP 6 最終硬化



※3 光照射時間について

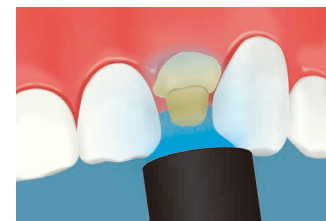
分類	光源	光量	照射時間
高出力LED照射器	青色LED	1500mW/cm ² 以上	（3秒又は5秒）×2回
LED照射器		800～1400mW/cm ²	10秒
ハロゲン照射器	ハロゲンランプ	400mW/cm ² 以上	10秒

・LED照射器：光源が青色LEDで発光スペクトルのピークトップが450～480nm
・ハロゲン照射器：有効波長域が400～515nm

残存歯質・コアに対して各面につき光照射※3を行う。1回の光照射で光硬化させる部位全てが照射径に入らない場合は、光照射を繰り返して全ての部位に対して光照射を行ってください。

コア装着後 10分以上経過後に支台歯形成

STEP 4 余剰セメントの半硬化



光重合による方法※2

一ヶ所につき 2～5秒光照射

※2 「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」を組み合わせた場合は、1～2秒光照射

化学重合による方法

補綴装置の装着から 2～4分保持

Q1 なぜ、プライマー処理不要で接着力を有するのですか？

A 「MDP®」と長鎖シランカップリング剤「LCSI」の配合により、様々な種類の被着体に対して、プライマー処理なしで接着します。「MDP®」はリン酸基部位が歯質のカルシウムや金属、ジルコニア等の表面と化学的に結合することによって高い接着性を発現します。さらに、独自の長鎖シランカップリング剤「LCSI」により、CAD/CAM冠やニケイ酸リチウムや歯科用陶材などに対してプライマー処理なしで接着することが可能です。

Q2 オートミックスとハンドミックスの性能に違いはありますか？

A 基本組成は同じで、両者とも同等の接着性能を有します。
操作余裕時間につき、ハンドミックスは2分間、オートミックスは1分間です。*いずれも遮光下(23℃)において

Q3 より高い接着を求める場合に組み合わせ可能な製品はありますか？

A 「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」を支台歯処理に用いることで、より高い接着強さが得られます。

Q4 歯面処理に「パナビア® V5」のトゥースプライマーは使用できますか？

A トゥースプライマーは「パナビア® V5」専用品のため、使用できません。
また、使用している化学重合触媒などが異なるため、十分な接着性を獲得することができません。

Q5 CAD/CAM冠の装着時に内面処理加算の対象となりますか？

A 保険適応の諸条件を満たした症例において、本品の添付文書記載の使用方法にしたい、歯科セラミックス用接着材料を適用することで、内面処理加算が可能です。

Q6 硬化が早いと感じるが、どのような原因がありますか？**A** **1** 環境光による硬化促進

デュアルキュア型のセメントである「SAルーティング® Multi」は採取・接着操作中にデンタルライトなどの強い光が当たると、硬化が促進されます。採取・接着操作時にはデンタルライトを消すなど、光量を下げる回避処置を行ってください。また、練和中や練和後のペースト（オートミックスタイプの場合には練和開始後はミキシングチップ及びガイドチップ）に対してもデンタルライトや太陽光などの強い光が当たりますと硬化が促進されますので、ペーストの練和後には速やかに接着操作を行ってください。

2 口腔内環境における硬化促進

「SAルーティング® Multi」などのレジンセメントは、口腔内など室温よりも高い温度になることや、補綴装置の接着操作において空気と触れない状況になると硬化が促進されます。特に窩洞へセメントを塗布した場合、40秒程度で初期硬化が開始されますので、速やかに補綴装置の接着作業を行ってください。（支台歯の前処理材として、「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」を併用した場合には装着後30秒程度で初期硬化が開始されます。）添付文書記載のとおり、ポストの植立などの症例でレントロを使用すると過度に硬化が早くなりますので、レントロは使用しないでください。

3 水分の混入による硬化促進

練和紙や練和棒に水滴が付着していると、硬化が早くなる場合がありますので、水滴が付着している場合は水滴を拭き取ってから使用してください。また、結露による水分混入を防ぐため、室温に15分以上放置してから使用してください。

Q7 硬化が遅い、余剰セメント除去時に補綴装置が外れた。

A 補綴装置が光を透過しない金属クラウンやインレー（アンレー）などの場合の最終硬化は装着後5分です。また、隣接部の余剰セメントを除去する際にフロスをご使用になる場合には、フロスを引き抜く際にマージン部に負荷がかかると補綴装置の脱落が起こることがありますので、補綴装置を押えながら、舌側や頬側方向へフロスを引き抜いてください。



Q8 コア、ポストの接着において、支台歯形成時にコアが外れた。

A 残存歯質やコア、ポストのヘッド部分に対して、十分な光照射が行われていたかご確認ください。また、装着直後に硬化したセメントに対して負荷がかかるコアやポスト植立などの症例では装着後10分以上経過後に支台歯形成を行ってください。

Q9 補綴装置の脱落が生じたが、どのような原因が考えられますか？

A 【接着不良につながる要因】

● ユージノール系の覆罩材、仮封材、仮着材を使用した場合

レジンセメントの硬化不良を起こす場合がありますので、使用しないでください。

● 過酸化水素水による窩洞清掃をした場合

歯質に過酸化水素水の残留が生じる為、接着強さの低下を招く恐れがありますので、使用しないでください。

● 硫酸鉄系の止血剤を使用した場合

変色や接着強さの低下を招く恐れがありますので、使用しないでください。

● 塩化アルミニウム配合の止血剤を使用した場合

塩化アルミニウム配合の止血剤が被着面に触れると、接着強さが低下する恐れがあるため、最小限の使用に留めてください。

● 歯質が汚染されている場合

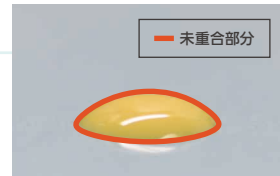
メタルコアが脱落した症例などのように歯質が著しく汚染されている場合には通法にしたがい、清掃を行ってください。また、アマalgamまたは裏装材が残留していると、本品の接着を妨げるため、窩洞形成時に完全に除去してください。

● ペーストの採取が等量でない場合

Aペースト、Bペーストの採取比が等量ではない場合、硬化が早くなったり、遅くなったりする場合がありますので、等量採取ができていることを確認してから使用してください。オートミックスタイプの場合、ミキシングチップ、ガイドチップを装着する前にペーストの試し出しを行い、AペーストとBペーストが等量採取できていることを確認してからご使用ください。

Q10 練和紙上で硬化を確認すると、硬化が遅い（又は硬化しない）

A 一般的にレジンセメントは、空気と触れていると硬化をしない『嫌気硬化性』という特性のため、練和紙上で硬化確認はできません。臨床的に口腔内で補綴装置を装着する条件（空気が遮られ、室温よりも温度が高い）になることでセメントの化学重合が促進されます。一方で、セメントの硬化性を確認する目的で練和紙上にセメントを放置しても、セメント表面が空気と触れていること、温度が低いことから長い時間放置をしてもセメントは不十分な硬化となります。これは上記のように『嫌気硬化性』の特性に起因するものです。



- ・ 空気と接触する表面や練和紙側は未重合層となります。
- ・ 練和した量が少ないとほとんど硬化しないこともあります。

Q11 装着直前に窩洞が唾液、血液などで被着面が汚染された場合の処置について

A 唾液、血液などで被着面が汚れた場合は、水洗などの清掃を行い乾燥した後に装着ください。「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」による支台歯処理を併用した場合において、唾液、血液等で処理面が汚染された場合は、その部位に水洗、乾燥、又はアルコール清掃を行った上、再度処理ください。 * 処理面が汚染されると接着強さが低下する場合があります。

Q12 キャップを閉める際に注意点はありますか？

A ペーストの採取後は正しい方向でキャップを装着ください。キャップの向きを間違えた場合、AペーストとBペーストが接触してシリンジ先端のペーストが硬化する恐れがあります。キャップやシリンジ先端がペーストで汚れた場合には、乾いたガーゼなどでふき取ってからキャップを装着してください。

Q13 最終硬化は何分ですか？

A 最終硬化時間は補綴装置の装着から5分です。コア・ポストの場合、支台歯形成は装着後10分以上経過後に行ってください。

Q14 セメントは補綴装置側と支台歯側にどちらに塗布するのが良いですか？

A 補綴装置側及び支台歯（窩洞）側への塗布のいずれも可能ですが、支台歯（窩洞）側へ塗布した場合には硬化が早まります。セメントを支台歯（窩洞）に塗布した場合には、40秒以内（「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」を併用した場合には30秒以内）に補綴装置の装着操作を行ってください。

Q15 レジンコア、メタルコアを装着した際に、形成するまでどの程度時間を空ければ良いですか？

A 支台築造の場合は装着後10分経過後に形成を行ってください。

Q16 「光を透過する補綴装置」とは、どのような補綴装置を指しますか？

A 例えば、CAD/CAMレジン冠や高透光性ジルコニアクラウン、シリカ系ガラスセラミックス、CRインレー、硬質レジンジャケットクラウンなど、いずれもオパークを使用していない場合が該当します。

Q17 ユージノール系の仮封材や根充材は使用してはいけないのでしょうか？ また、その理由は？

A レジンセメントの重合を阻害してしまい、接着性や硬化性が低下する為です。

Q18 メタルボンドの接着に使用できますか？ 内面が金属であれば問題ありませんか？

A 「SAルーティング® Multi」は非貴金属合金、貴金属合金ともに接着が可能です。さらに、マージン部をカラーレスとして作成されている場合にもシランカップリング処理なしで接着可能です。

Q19 ファイバーポストの接着に使用できますか？

A 使用可能です。
ファイバーポストへのプライマー処理は不要ですが、試適を行ったあとの清掃は通法にしたがい行ってください。

Q20 補綴装置装着後に脱離してしまった。セメントは歯質側に残っている。その原因は？

A 補綴装置の被着面が「SAルーティング® Multi」の適応材料であるかご確認ください。
適応する被着面の場合は、内面のサンドブラスト処理や洗浄が十分に行えていたかどうか、硬化時間を十分に確保していたかどうか、咬合などで過度な負荷がかかっていないかをご確認ください。

Q21 補綴装置装着後に脱離してしまった。セメントは補綴装置側に残っている。その原因は？

A 支台歯側の被着面が「SAルーティング® Multi」の適応材料であるかご確認ください。
適応する被着面の場合は仮着材や仮封材の除去などが十分に行えていたかどうか、硬化時間を十分に確保していたかどうか、咬合などで過度な負荷がかかっていないかをご確認ください。

Q22 製品の保管方法を教えてください。

A 2～25℃の室温で保管ください。
保管に際しましては、直射日光・デンタルライトなどを避けてください。
また、夏季など室温が上記の保管温度を超える場合には冷蔵庫での保管をお願いいたします。